

Stereo-seq 大芯片 保存操作指南

收到后

Stereo-seq 芯片装于真空密封的铝袋中, 冷链运输。

请及时确认铝袋是否完好并处于真空密封状态, 随后立即将未开封的Stereo-seq 芯片储存在2°C~8°C。

未开封的情况下, 产品可在2°C~8°C保存至标签上的有效期。

打开后

如Stereo-seq 大芯片盒打开后芯片并未使用，参照[重新封装操作指引](#)将大芯片正确放入芯片盒并与干燥剂一起重新密封。

再次确认铝袋是否完好并处于密封状态，随后立即将铝袋储存在2°C~8°C。未真空密封的芯片不可放置超过两周，开封后请尽快使用。

请您拆开铝袋后检查以下事项：

- ☐ 芯片种类与包装描述不符
- ☐ 芯片数量与产品规格不符
- ☐ 芯片正面有肉眼可见划痕

如果您发现产品存在上述问题，请及时将情况反馈给科研合作代表或技术人员。

操作指南

芯片盒通过上盖的圆柱和斜压角将Stereo-seq芯片抵压在底座的芯片腔室上，限制芯片移动。

请注意：

- ◆ 标签纸切开后，芯片即处于松脱状态。
- ◆ 保持芯片盒底座水平放置，且芯片腔室朝上。防止芯片掉落。



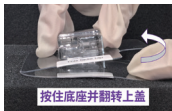
操作指南

- a. 将芯片盒放置在桌面，并将写有“**This Side Up**”的方向朝上。
 - b. 将刀片伸入芯片盒中间缝隙，切开两边标签纸。
- △ 如需拿起芯片盒寻找切入口，请轻轻捏住芯片腔室。以防芯片松脱移位。



操作指南

- c. 按住底座露出部分，轻轻捏住上盖并翻转打开。



※ 注意：

不要大角度折弯芯片盒开口。
这样会导致芯片盒越卡越紧。

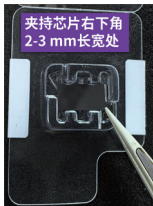


操作指南

- d. 用镊子夹持芯片长边中间位置取出芯片。
- 或 用钝头镊子夹持芯片右下角2-3 mm长宽处取出。



或



重新封装

- 芯片盒底座平放在桌面上，防止芯片盒掉落或翻转导致芯片受损。
- 将芯片正面朝上且完全平放到芯片腔室的平台内。可使用镊子夹持芯片长边中间或夹持芯片右下角2-3 mm长宽处以调整芯片位置。



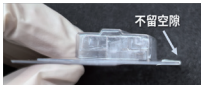
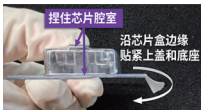
※ 注意：

不要让芯片卡在台阶上。



重新封装

- c. 将芯片盒上盖翻折与底座重新扣合。
- d. 用耐受 $0^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 的单面胶，按原有“**This Side Up**”标签的位置贴在芯片盒上盖两边。
- e. 捏住芯片腔室的上盖和底座，将单面胶翻折并沿芯片盒边缘紧密贴合到底座底面。
- f. 将芯片盒与干燥剂重新放回原装铝袋中，尽量挤出袋内气体并重新密封。



更多产品指南

请前往查看或下载:

[www.stomics.tech/resources/
Documents](http://www.stomics.tech/resources/Documents)



Step 1: 在页面右侧勾选栏中点击想要查看的指南类型。

Step 2: 点击“在线浏览”可进入预览页面, 点击“下载”可进入下载页面。

请在标签标注的有效期内及时下载芯片mask文件, 以确保您高效顺畅地完成数据分析。



扫码获取更多信息

联系我们

网址: <https://www.stomics.tech/>

邮箱: services@stomics.tech